

Toshiba esporrà una gamma di nuovi prodotti e tecnologie a Embedded World 2019

Al padiglione 3A, Stand 424 saranno previste dimostrazioni sulla connettività Gigabit Ethernet per automotive e sulle nuove soluzioni di controllo dei motori

Düsseldorf, Germania, 7 Febbraio 2019 – Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) ha annunciato oggi la propria partecipazione alla fiera Embedded World 2019. La società presenterà una vasta gamma di nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, fra cui un bridge Gigabit Ethernet per automotive con supporto per AVB/TSN, nuove soluzioni di controllo dei motori passo passo e una soluzione competitiva per la riduzione del time-to-market e dei costi dei progetti ASIC.

I visitatori potranno esaminare l'IC ponte Ethernet AVB/TSN TC9562XBG, ideale per un mercato automotive che sta passando a soluzioni di rete ad alta velocità. Il dispositivo supporta i requisiti di connettività di rete in tempo reale dei veicoli connessi di oggi e dei sistemi di guida assistita, con una velocità di trasferimento dati fino a 1 Gbps. Oltre a rispettare le specifiche Ethernet AVB, esso soddisfa anche le specifiche TSN, il che lo rende adatto anche per il mercato industriale. A supporto di una vasta gamma di strati fisici Ethernet e di switch, il TC9562XBG presenta le interfacce MII, RMII, RGMII e SGMII.

Il driver del motore passo-passo TB67S128FTG ha anche lo scopo di assicurare il risparmio energetico, pur mantenendo un controllo accurato. Il dispositivo supporta l'avanzamento in microstep 1/128, che lo rende adatto per le applicazioni più disparate quali le stampanti 3D, gli sportelli bancomat e gli elettrodomestici, riducendo al contempo il rumore generato durante il funzionamento. Al cuore del nuovo dispositivo si trova la tecnologia di controllo attivo del guadagno (AGC) di Toshiba, che ottimizza la corrente in base alla coppia richiesta, impedendo così lo stallo e consentendo di ottenere risparmi energetici. Il funzionamento con una coppia superiore è reso possibile dall'elevata corrente di azionamento (50V / 5A), mentre la bassa resistenza di on (0,25Ω) riduce la generazione di calore.

Gli ingegneri saranno anche a disposizione per fornire supporto e consigli ai visitatori che intendono ricorrere al nodo di processo di fabbricazione FFSA™ (Fit Fast Structured Array) da 130nm, annunciato di recente. Destinato principalmente alle applicazioni industriali, quest'ultimo si aggiunge al portafoglio attuale dei processi da 28, 40 e 65nm di Toshiba, introducendo così un'altra opzione per le applicazioni industriali. Il nodo di processo FFSA™ da 130nm offre diverse slice master con un massimo di 664kb di RAM e circa 912.000 gate per dispositivo.

Embedded World 2019 si terrà dal 26 al 28 Febbraio 2019 a Norimberga, in Germania, e Toshiba* si troverà al padiglione 3A stand 424, con il proprio team di tecnici a disposizione per discutere sui prodotti nuovi ed esistenti e per rispondere alle questioni tecniche.

###

Nota per i redattori:

* embedded world 2019: Toshiba Memory Europe GmbH esporrà congiuntamente con Toshiba Electronics Europe GmbH.

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html
E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +44 (0)193 282 2832
E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek
Tel: +44 (0) 20 8429 6554
Web: www.publitek.com
E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Rif.: Febbraio 2019

Rif. 7200/A.